

证券代码：301511

证券简称：德福科技

九江德福科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	具体名单见附件
时间	2025年4月21日 16:00-17:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书 吴丹妮女士 投资者关系经理 左净霁女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司经营情况介绍</p> <p>公司于2025年4月19日发布2024年年度报告和2025年一季度报告。2024年公司实现营业收入78.05亿元，同比增加19.51%；归属于上市公司股东的净利润为-2.45亿元，同比下降284.56%；归属于上市公司股东的扣非净利润为-2.36亿元，同比下降442.96%。</p> <p>2025年第一季度公司实现营业收入25.00亿元，同比增加110.04%；归属于上市公司股东的净利润为1820.01万元，同比增加119.21%；归属于上市公司股东的扣非净利润为588.70万元，同比增加105.66%。</p> <p>二、问答环节</p> <p>1、公司2024年和2025年第一季度销量、产能情况</p> <p>答：2024年公司实现电解铜箔销售9.27万吨，同比增长17.18%；2025年第一季度实现电解铜箔销售2.96万吨，同比增长102%。截至2025年一季度，公司产能15万吨/年，预计2025年第二季度将有2.5万吨在建产能投产试运行。2025年公司将继续以高端产品加速放量作为全年战略目标，不以低价抢单恶化市场竞争。</p> <p>2、公司2025年第一季度盈利改善的原因？</p> <p>答：2025年第一季度整体保持较高开工率，销量较去年同期翻倍，锂电铜箔高附加值占比继续保持40%以上，电子电路铜箔部分产品加工费有上修调整，同时高阶RTF、HVLP第1-3代加快批量导入，带动公司整体利润修复。</p>

3、美国关税对公司业务的影响？

答：公司产品没有直接出口到美国，海外客户仅涉及日韩和欧洲，无直接影响。公司自 2023 年起开启全球布局本地化配套客户，目前正在筹备欧洲建厂和东南亚销售布点。

4、宁德时代近期推出 12C 铁锂快充、自生成负极等新品，公司是否有相关配套产品？

答：公司珠峰实验室与头部电芯客户各家实验室保持紧密联系，聚焦前沿创新技术，努力为客户最新需求提供全套电解铜箔解决方案。目前公司在下一代电池技术领域用铜箔已取得前瞻性布局成果，匹配全固态/半固态电池、锂金属电池及低空飞行器专用锂离子电池技术方向，包括 PCF 多孔锂电铜箔、雾化铜箔、芯箔等在内的多款新型锂电铜箔，并均已具备量产能力，其中 PCF 多孔锂电铜箔和雾化铜箔于今年 3 月已实现批量生产。

(1) PCF 多孔铜箔：作为新型集流体材料，通过独特的孔隙结构设计有效解决了传统致密铜箔在锂电池应用中面临的界面接触、离子传输和应力缓冲等问题。多孔铜箔可使锂电池能量密度提升 15-20%，特别适用于硅基负极、锂金属负极等高能量密度电池体系以及固态电池体系，孔隙结构可引导锂金属电池中的锂均匀沉积，孔隙结构增加固-固接触点能有效降低界面阻抗。

(2) 雾化铜箔：通过表面处理的方式将铜箔的 2D 表面结构转变为 3D 结构，有望抑制锂枝晶生长，且更大的比表面积可提高负极粘结力，多级粗糙结构可缓冲负极的体积膨胀，可作为硅基负极用的半固态/全固态电池和锂金属负极电池的解决方案。

(3) 芯箔：通过表面处理，其可在 200℃ 条件下保持 3 小时不氧化，能提升电池的高温循环寿命，适合电动汽车快充、航空航天等高温应用场景以及含硫的固态电池。

5、公司电子电路铜箔国产替代进展如何？

答：2024 年公司研发投入为 1.83 亿元，同比增长 30.45%，新增约 17 件发明专利，填补多项行业技术空白，在多个国产化替代项目的交付中展现了公司强大的研发实力。在电子电路铜箔领域，公司持续深化“高频高速、超薄化、功能化”技术战略。公司与生益科技、台光电子、松下电子、联茂电子、华正新材、鼎鑫电子、深南电路、胜宏科技等知名 CCL 和 PCB 厂商建立了稳定的合作关系，为其供应链国产化需求提供电解铜箔解决方案，目前高端产品国产替代符合预期。

(1) RTF：RTF-3 已实现对多家 CCL 客户实现批量供货，粗糙度降至 1.5 μm 、颗粒尺寸 0.15 μm ，抗剥离强度不低于 0.53N/mm (M7 级 PPO 板材)，适配高速服务器、Mini LED 封装及 AI 加速卡需求。RTF-4 进入客户认证阶段。

(2) HVLP：HVLP1-2 已批量供货，主要终端应用于英伟达项目及 400G/800G 光模块领域。HVLP3 已通过日系覆铜板认证，应用于国内算力板项目，预计 2025 年该款产品将加速放量。HVLP4 在与客户做试验板测试，HVLP5 处于特性分析测试。

(3) 载体铜箔：自主研发的 3 μm 超薄载体铜箔 (C-IC1) 已通过国内存储芯片龙头可靠性验证和工厂制造审核，自今年 3 月起开始供货。带载体可剥离超薄铜箔是制备难度最高的铜箔产品之一，该产品技术多年被日系及欧洲电子电路铜箔等公司垄断，公司

	<p>通过持续研发投入，成为国内首家载体铜箔国产替代量产厂家，该产品可满足芯片封装基板超微细线宽线距需求。</p> <p>6、当下公司利润修复后，公司未来战略方向如何？</p> <p>答：公司于 2024 年 11 月 28 日发布《关于拟向全资子公司划转部分资产及业务整合的公告》，优化公司管理架构，整合内部资源，推动上市公司的集团化发展。未来将充分利用自身化学工业创新平台优势，通过大量交叉学科技术的应用，引领电解铜箔材料性能持续升级，以匹配下游 AI 硬件、机器人、高性能锂电池等应用领域的高速发展，同时不断发展颠覆性铜箔制造技术，以铜箔为主要终端产品电子级化学品为副产品，实现制造过程能耗大幅下降及原子经济性，利用制造过程循环将企业整合成综合性的化工电子材料集团。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025年4月21日

参会名单（排名不分先后，按拼音排序）：

Ofionk Capital、北京鸿道投资管理有限责任公司、北京橡果资产管理有限公司、财通证券股份有限公司、财通证券资产管理有限公司、长城财富保险资产管理股份有限公司、长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、大家资产管理有限责任公司、东方证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、复通（山东）私募投资基金管理有限公司、光大理财有限责任公司、广东正圆私募基金管理有限公司、广发乾和投资有限公司、广发证券股份有限公司、硅谷天堂产业集团股份有限公司、国惠（香港）控股有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰海通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、鸿运私募基金管理（海南）有限公司、华安财保资产管理有限责任公司、华福证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、平安银行股份有限公司、瑞士银行、瑞银集团、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、上海晨燕资产管理中心（有限合伙）、上海度势投资有限公司、上海瀚伦私募基金管理有限公司、上海合道资产管理有限公司、上海健顺投资管理有限公司、上海九祥资产管理有限公司、上海瑞潇投资管理中心（有限合伙）、上海森锦投资管理有限公司、上海渊泓投资管理有限公司、上海云门投资管理有限公司、深圳前海亿阳投资管理有限公司、深圳市鹏举投资有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、深圳市兴亿投资管理有限公司、深圳中天汇富基金管理有限公司、世纪证券有限责任公司、世嘉控股集团（杭州）有限公司、太平洋证券股份有限公司、泰山财产保险股份有限公司、同泰基金管理有限公司、五矿证券有限公司、西部利得基金管理有限公司、西部证券股份有限公司、向三创股份公司、兴业证券股份有限公司、英大证券有限责任公司、圆信永丰基金管理有限公司、招商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中航证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投（国际）金融控股有限公司、中信建投证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司